

杭州东忠科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司拟向银行申请授信的情况

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，拟确定公司及子公司 2024 年向金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币 5,000.00 万元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

以上授信额度不等于公司的实际融资总额，实际融资总额以公司与银行实际发生的金额为准。公司及控股子公司以房产、应收账款、知识产权等资产提供抵押担保。公司关联方将根据需要提供房产、应收账款、保证金等为上述授信提供担保。

二、审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《预计公司及子公司2024年度向金融机构申请综合敞口授信额度》议案。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响

公司本次申请授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十次会议决议》

杭州东忠科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日